

### 关键指标

频率: 5~6GHz  
 功率增益: 23dB  
 输出功率: 46dBm(40W)  
 功率附加效率: 53%  
 工作电压: VD: +28V (脉冲), VG: -2.35V  
 静态电流: 43mA  
 封装形式: 载板式  
 产品尺寸: 8mm×8mm×0.75mm

### 产品简介

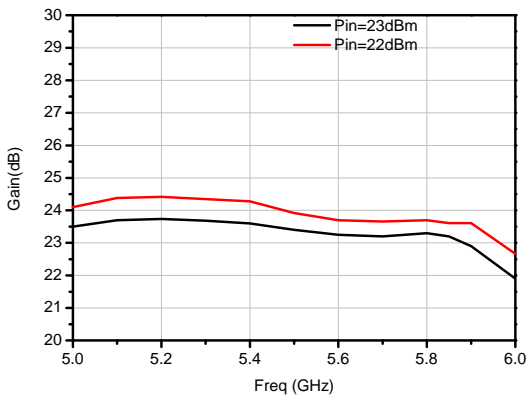
HG534F3 是一款 C 波段小型化载板式内匹配功率放大器, 功率增益为 23dB, 输出功率为 40W, 全频带内功率附加效率为大于 50%。

电性能 (Vds:28/0V, Vg:-2.35V, Ids:43mA  
 T:750us,W:150us, 占空比 20%, Pin=23dBm)

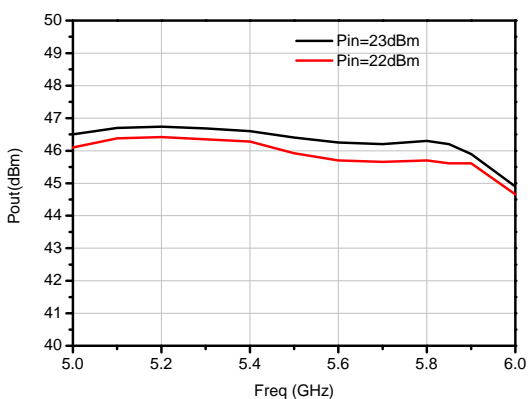
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	5~6		
功率增益(dB)	—	23	—
增益平坦度(dB)	—	±1	—
输出功率(W)	—	40	—
功率附加效率 (%)	—	53	—

### 典型测试曲线

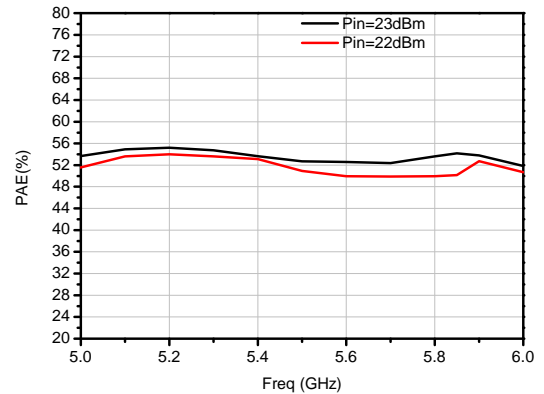
功率增益 (Vds:28/0V, Vg:-2.35V, Ids:43mA  
 T:750us,W:150us, 占空比 20%)



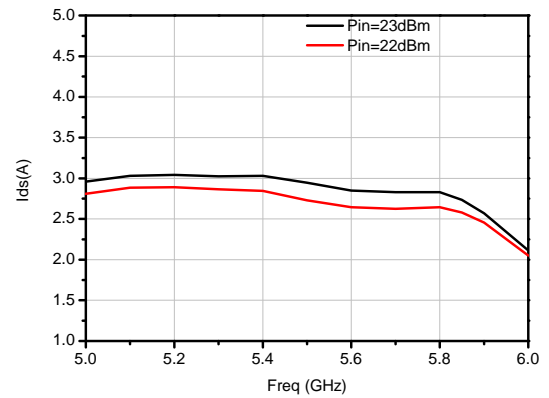
输出功率 (Vds:28/0V, Vg:-2.35V, Ids:43mA  
 T:750us,W:150us, 占空比 20%)



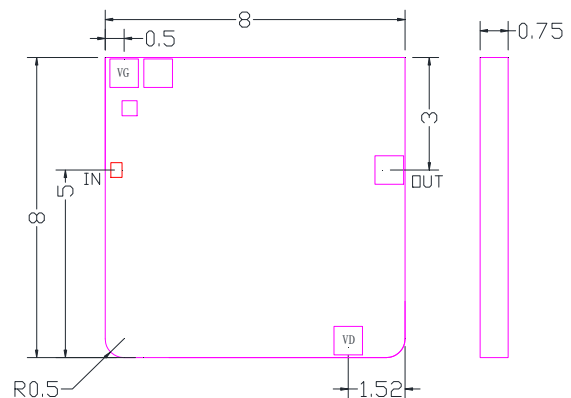
功率效率 (Vds:28/0V, Vg:-2.35V, Ids:43mA  
 T:750us,W:150us, 占空比 20%)



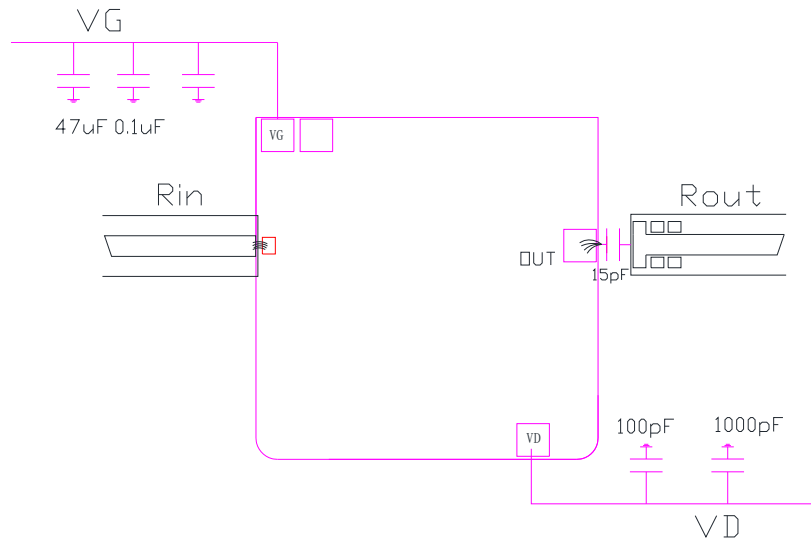
工作电流 (Vds:28/0V, Vg:-2.35V, Ids:43mA  
 T:750us,W:150us, 占空比 20%)



### 外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	36V
最大输入功率	+30dBm
工作温度	-55℃~85℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 器件内部含有单片集成电路，属静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品为载板式功率器件，已采用金锡合金烧结芯片，使用时采用银锡合金进行载板烧结；
3. 放大器输入有隔直电容，输出无隔直电容，建议使用 15pF 芯片电容进行隔直，放大器输出端与隔直电容采用 4 根  $\Phi 25\mu\text{m}$  金丝进行键合，金丝长度小于 400 $\mu\text{m}$ ，输出微带线压焊电宽度适当增宽，预留功率调试小岛。